

請求の範囲

- [請求項1] エポキシ樹脂と、高温硬化型架橋剤と、無機微粒子とを含有する電磁鋼板用コーティング組成物であって、
- 前記エポキシ樹脂の100質量部に対し、前記高温硬化型架橋剤が5～30質量部であり、
- 前記無機微粒子は、金属水酸化物、25℃で水と反応して金属水酸化物になる金属酸化物、及び水酸基を有する珪酸塩鉱物から選択される1種以上であり、
- 前記無機微粒子は、体積平均粒子径が0.05～2.0μmであり、
- 前記エポキシ樹脂の含有量は、前記電磁鋼板用コーティング組成物の総質量に対して、45質量%以上であり、
- 前記無機微粒子の含有量は、前記エポキシ樹脂100質量部に対して、1～100質量部である、電磁鋼板用コーティング組成物。
- [請求項2] 前記無機微粒子が、水酸化アルミニウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、タルク、マイカ及びカオリンから選択される1種以上である、請求項1に記載の電磁鋼板用コーティング組成物。
- [請求項3] 前記高温硬化型架橋剤が、芳香族アミン、フェノール系硬化剤及びジシアンジアミドから選択される1種以上である、請求項1又は2に記載の電磁鋼板用コーティング組成物。
- [請求項4] 請求項1～3のいずれか一項に記載の電磁鋼板用コーティング組成物を塗布してなる絶縁被膜を表面に有する、接着用表面被覆電磁鋼板。
- [請求項5] 請求項4に記載の接着用表面被覆電磁鋼板を2枚以上積層してなる、積層鉄心。